

COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

フェローテック

6890 東証スタンダード市場

企業情報はこちら >>>

2025 年 8 月 14 日 (木)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

目次

■ 要約	01
1. 2025 年 3 月期業績（実績）	01
2. 2026 年 3 月期業績（予想）	01
3. 中期経営計画	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 沿革	03
■ 事業概要	04
1. 事業セグメント	04
2. 半導体等装置関連	05
3. 電子デバイス	07
4. 車載関連	08
5. その他	08
6. 特色、強み	08
■ 業績動向	09
1. 2025 年 3 月期の業績概要	09
2. セグメント別概況	12
3. 主な投資と減価償却費	14
■ 今後の見通し	15
1. 2026 年 3 月期の業績見通し	15
2. サブセグメント別見通し	16
3. 投資額と減価償却費の見通し	17
■ 中長期の成長戦略	18
1. 中期経営計画の基本方針	18
2. 定量的目標（KPI）	18
3. 主要製品別戦略と売上高目標	19
4. 主な工場新設・生産能力増強の状況	21
■ 株主還元策	22

■ 要約

2025 年 3 月期は増収ながら、償却負担増などで営業利益は微減

フェローテック <6890> の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC（化学蒸着法炭化ケイ素）、磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基板など様々な製品、装置、部品、素材等の製造・販売だが、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。

1. 2025 年 3 月期業績（実績）

2025 年 3 月期の業績は、売上高が前期比 23.4% 増の 274,390 百万円、営業利益が同 3.1% 減の 24,089 百万円、経常利益が同 3.7% 減の 25,558 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同 3.6% 増の 15,692 百万円となった。主力の半導体等装置関連は増収となったが、新工場の立ち上げに伴う償却負担や経費増で減益となり、これが全体の利益の足を引っ張った。セグメント別の売上高は、半導体等装置関連が同 27.0% 増、電子デバイスが同 21.0% 増、今期から新区分となった車載関連が同 17.7% 増、その他が同 13.9% 増となった。法人税等が 5,746 百万円（前期は 5,510 百万円）になったこと、非支配株主に帰属する当期純利益が 3,607 百万円（同 5,481 百万円）に減少したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比で増益となった。設備投資額は 51,776 百万円（同 75,227 百万円）と減少したものの、一方で減価償却費は 23,672 百万円（同 16,398 百万円）となった。

2. 2026 年 3 月期業績（予想）

2026 年 3 月期の業績は、売上高 285,000 百万円（前期比 3.9% 増）、営業利益 28,000 百万円（同 16.2% 増）、経常利益 26,000 百万円（同 1.7% 増）、親会社株主に帰属する当期純利益 16,000 百万円（同 2.0% 増）を見込んでいる。世界的に半導体市場が踊り場を迎えている状況で、先行きも不透明であることから主力の半導体等装置関連は同 7.4% 増を見込んでいる。一方で、AI 関連向けサーモモジュールがけん引して電子デバイスは同 12.7% 増の予想。車載関連は、パワー半導体基板やセンサが増加することから同 17.8% 増を見込み、その他は太陽光関連の縮小で同 47.5% 減を見込んでいる。その結果、営業利益は増益予想となっているが、為替が円高に振れていることなどから営業外収益が減少する見込みで、経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益は微増予想となっている。設備投資額は 65,000 百万円と増加し、減価償却費は 27,000 百万円を見込んでいる。

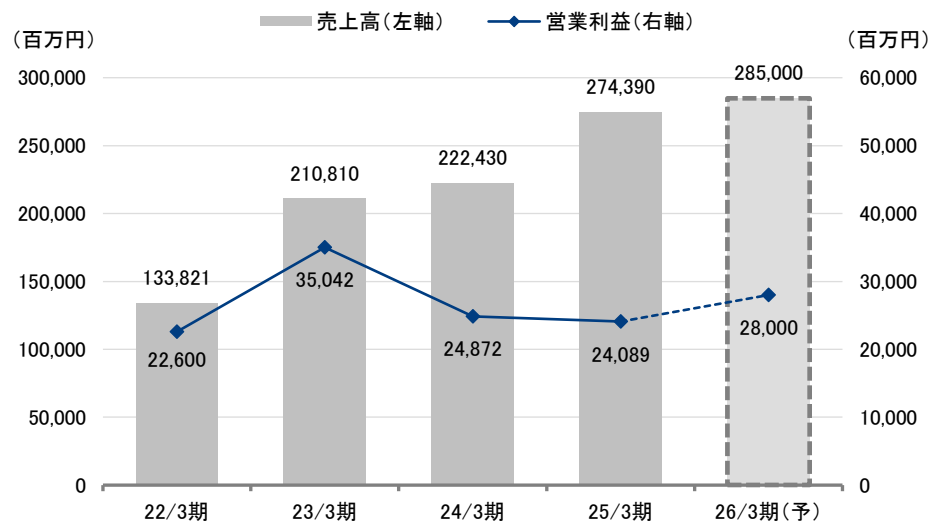
3. 中期経営計画

同社は、2027 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を発表済みだが、初年度の 2025 年 3 月期の業績が当初計画を下回ったことから、この計画をロールオーバーした。新たな定量的な最終目標として、2028 年 3 月期に売上高 4,000 億円、営業利益 470 億円、営業利益率 11.8%、ROE15%などを掲げている。またこの間の設備投資総額（累計）は 1,400 億円を計画している。引き続き成長ドライバーとして、半導体材料（石英製品、セラミックス、シリコンパーツ等）、半導体サービス（装置部品洗浄、石英坩堝、再生ウエーハ等）、半導体金属・装置（金属加工、蒸着装置等）、電子デバイス（サーモモジュール、パワー半導体基板等）を挙げており、この方針は変わっていない。足元の業績はやや足踏みしているが、基本的な戦略を粛々と進める方針だ。

Key Points

- ・シリコンやセラミックス等の無機系製品の大手メーカー。半導体業界向けが多い
- ・2025 年 3 月期は増収ながら経費や償却負担増で前期比 3.1% の営業減益
- ・中期経営計画をロールオーバーし、2028 年 3 月期に営業利益 470 億円を目指す

業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

■ 会社概要

シリコン、セラミックス等無機系製品の大手メーカー

1. 会社概要

同社は 2025 年 3 月末現在（有価証券報告書）では、傘下に連結子会社 80 社、持分法適用会社 13 社を擁する純粋持株会社であったが、2025 年 7 月 1 日付で国内事業子会社である（株）株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併し、事業持株会社になるとともに、社名を（株）フェローテックに変更した。もともとは 1980 年に米国 Ferrofluidics Corporation（現 Ferrotec (USA) Corporation）の日本法人（旧 日本フェローフルイディクス（株））として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC、磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基板など主に無機材料を使った様々な製品、装置、部品、素材等の製造・販売である。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。そのため、世界的に著名な大手半導体製造装置メーカーが主要顧客となっている。

2. 沿革

同社は 1980 年に米国企業の日本法人として設立された。親会社製品（真空シール等）の輸入販売が主たる業務であったが、1982 年には千葉県に工場を建設し、自社生産を開始した。自社製品比率が高まるにつれて、親会社との関係が薄れてきたため、1987 年には親会社から完全に独立し、独自路線を歩み始めた。その後も HDD 用ラミネートシール、超高真空用フッ素系磁性流体などの自社製品を開発し、1992 年には初の中国拠点（杭州市）を設立、1995 年には中国 2 つ目の製造拠点を上海市に設立し、さらに同年に社名を「株式会社フェローテック」に改称した。

その後も製品群や事業の拡大を続け、1999 年には元の親会社である Ferrofluidics Corporation を友好的 TOB により子会社化した。21 世紀に入ってから、2001 年に米国 Amerigon Incorporated（現 Gentherm Incorporated）と自動車温調システムで業務提携、2002 年には中国上海工場で小口径シリコンウエーハの受託加工を開始、2005 年にはロシアのサーモモジュールメーカー SCTB NORD（現 Ferrotec Nord Corporation）を子会社化した。さらに 2010 年には英国 Edwards Vacuum Inc から真空蒸着装置事業を取得し、2011 年には中国銀川市に大型工場を新設、2015 年には CVD-SiC 製品の製造・販売を行う（株）アドマップ（現（株）フェローテック）に、2016 年には産業用クリーニング機器の製造・販売を行う（株）アサヒ製作所に資本参加して子会社化し、事業の拡大を続けた。2017 年 4 月には持株会社制に移行し、現在では日本、欧州、米国、中国、東南アジアなど世界 9 ヶ国に製造子会社及び販売会社を有する国際的な企業となっている。2025 年 7 月 1 日付で国内事業子会社である（株）フェローテックマテリアルテクノロジーズを吸収合併し、事業持株会社になるとともに、社名を（株）フェローテックに変更した。

株式については、1996 年 10 月に日本証券業協会へ店頭登録し、現在は東京証券取引所スタンダード市場に上場している。

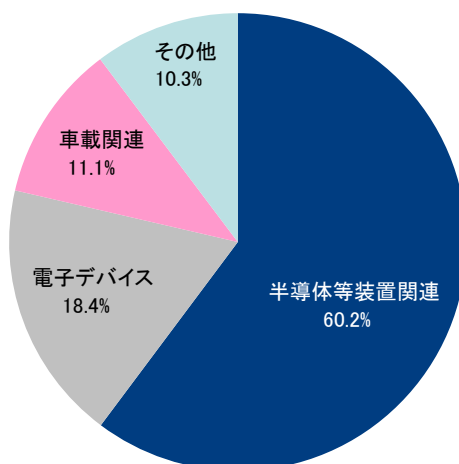
事業概要

事業内容は多岐にわたるが、主力は半導体等装置関連事業

1. 事業セグメント

同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時に M&A によって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたっている。現在のセグメントは半導体等装置関連（2025 年 3 月期売上高比率 60.2%）、電子デバイス（同 18.4%）、車載関連（同 11.1%）、その他（同 10.3%）に分かれる。

セグメント別売上高比率
(2025年3月期:274,390百万円)



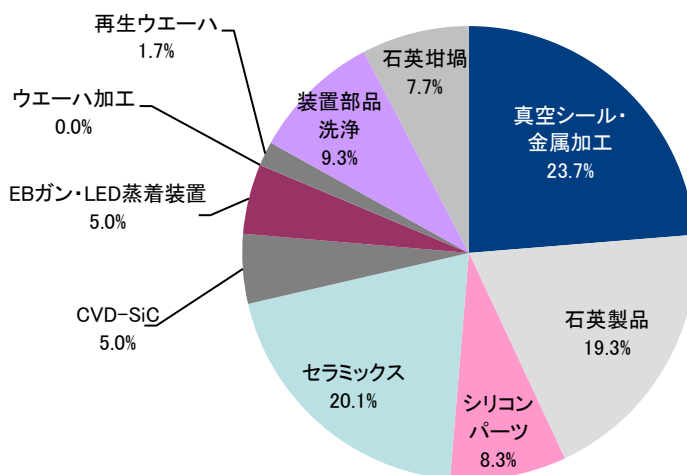
出所：決算説明資料よりフィスコ作成

事業概要

2. 半導体等装置関連

当セグメントは、さらに真空シール・金属加工、石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC、EB ガン・LED 蒸着装置、ウエーハ加工、再生ウエーハ、装置部品洗浄、石英坩堝のサブセグメントに分かれる。

半導体等装置関連サブセグメント別売上高比率
(2025年3月期:165,245百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) 真空シール・金属加工 (2025 年 3 月期対総売上高比率 14.3%)

磁性流体を利用して、真空雰囲気内への回転導入機としての役割を担う部品で、半導体・FPD・LED・太陽電池等の製造工程で利用されている。同社の核となる製品で、主に半導体ウエーハのエッチングや成膜工程、FPDのパネル搬送用ロボットの回転機構部などに導入され、密閉空間を外部から隔離しつつ加工に必要な動力を正確に伝えることを可能にしている。

(2) 石英製品 (同 11.6%)、シリコンパーツ (同 5.0%)

石英製品は熱と化学変化に強い超高純度のシリカガラスからなり、ウエーハの成膜生成や拡散プロセスなどで使われるほか、搬送や洗浄工程で治具、消耗品として使われており、微細化・高純度化が進む半導体製造プロセスのなかで重要な役割を担っている。シリコンパーツ（ポート、インジェクター、フォーカスリング等）は、加工して主に半導体製造工程等で使われる。

(3) セラミックス (同 12.1%)

同社が持つ素材技術、生産技術、精密加工技術を生かして様々なセラミックス製品を提供している。セラミックス製品は高強度・高純度・高耐熱性に優れたファインセラミックス（FC）製品と高度な機械加工が可能なマシナブルセラミックス（MC）製品に分けられる。前者は主に半導体製造装置用の部品として使われているが、特にドライエッチング方式（プラズマエッチャー）では不可欠な部品となっている。後者は様々な加工を施すことで各種部品や治具として利用されるが、特に半導体の検査工程での治具（ウエーハプロバー用）として需要が高まっている。また近年では、その精密加工特性を生かして高度な医療用機器での利用も進んでいる。

事業概要

(4) CVD-SiC (同 3.0%)

独自の CVD 方式による炭化ケイ素 (SiC) 製品で、超高純度・高耐熱性・高耐摩耗性・耐腐食性といった特性を備えている。半導体製造工程で用いられるウエーハポートやチューブ、シリコンウエーハの代替となるダミーウエーハなど、主に高温で使用される治具として幅広く活用されている。

(5) EB ガン・LED 蒸着装置 (同 3.0%)

EB (Electron Beam) ガンとは電子銃のことで、高機能な EB ガンと高圧電源を心臓部とした米国製 Temescal 装置 (精密蒸着装置) によって基盤などに薄膜を形成する。同社は大学や研究所向けの小規模生産用タイプから、大規模生産用高スループットタイプまで幅広い製品群を揃えている。次世代通信などで利用が見込まれる化合物半導体での世界標準機として数多くの顧客に使用されており、現在では LED や通信チップ製造プロセス等での導入が進んでいる。

(6) ウエーハ加工 + 再生ウエーハ (同 1.0%)

ウエーハ加工ではシリコンウエーハ (集積回路の基盤材料) を製造している。また 2022 年 3 月期より、中国半導体国産化の加速による需要の急増を受けて、新たに再生ウエーハ事業を立ち上げた。再生ウエーハとは、設備の確認やテストで使用したダミーウエーハを研磨加工することで繰り返し使えるようにしたウエーハのことである。半導体の生産が高まると、それに伴い再生ウエーハの需要も高まる。

(7) 装置部品洗浄 (同 5.6%)

半導体製造装置用部品の洗浄作業を行う。

(8) 石英坩堝 (同 4.6%)

同社の石英坩堝は、半導体製造工程に不可欠な石英製品と同等の高純度の原料を使用し、単結晶シリコンの原料を充填する容器として使用されている。半導体用、太陽電池用などの単結晶シリコンを製造するメーカーが主な顧客である。ただし今後は、太陽光発電 (PV: Photovoltaic) 向けは順次縮小する方針だ。

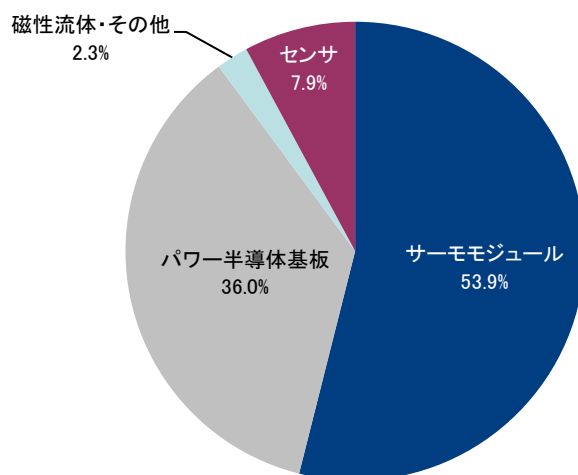
事業概要

3. 電子デバイス

当セグメントは、サーモモジュール、パワー半導体基板、磁性流体・その他、センサの 4 つのサブセグメントに分かれる。※

| ※ 2025 年 3 月期から、それまで電子デバイスに含まれていた自動車向け製品を新たに「車載関連」として切り分けている。 |

電子デバイスサブセグメント別売上高比率
(2025年3月期:50,487百万円)



出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(1) サーモモジュール (2025 年 3 月期対総売上高比率 9.9%)

サーモモジュールは、2 種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動するという効果を利用した板状の半導体冷熱素子（ペルチェ素子）である。小型・軽量でフロン要らずといった特長があり、自動車の温調シートをはじめ、冷却チラー、光通信、バイオ、エアコン、ドライヤーなど様々な家電製品にも採用されているが、2025 年 3 月期から車載用を別セグメントとして切り分けている。したがって、当サブセグメントに含まれるものは自動車向け以外である。

(2) パワー半導体基板 (同 6.6%)

パワー半導体基板とは、サーモモジュール製造技術を応用して、アルミナや窒化アルミニウムセラミックスに銅回路板を接合した放熱用絶縁基板のことである。同製品は、電車や電動車、エアコン、サーバー等の小型化・省エネ化に寄与しており、今後の需要増が期待される製品である。特に、自動車の EV 化が進むと、IGBT※などのハイパワー半導体が必要となり、その製造のためには同社の基板が必須部品となる。なお当サブセグメントも 2025 年 3 月期から車載用を別セグメントとして切り分けている。

| ※ IGBT とは、絶縁ゲート型バイポーラトランジスター（Insulated Gate Bipolar Transistor）の略で、パワートランジスターの一種。 |

事業概要

(3) 磁性流体・その他 (同 0.4%)

磁性流体とは液体でありながら、外部磁場によって磁性を帯び、磁石に吸い寄せられる機能性素材である。1960 年代の NASA スペースプログラムで、無重力環境における燃料輸送等の目的で開発された。現在では、スピーカーやアクチュエーター、センサ、分別リサイクル用途のほか、同社の主力製品の 1 つである真空シールにも利用されている。

(4) センサ (同 1.4%)

2022 年 8 月から連結子会社となった (株) 大泉製作所が製造するサーミスタセンサや関連する部品などが含まれる。なお大泉製作所は決算期変更を行ったため、2025 年 3 月期の連結決算には 9 ヶ月分だけが含まれている。また、当サブセグメントも自動車向けは 2025 年 3 月期から別セグメントとして切り分けている。

4. 車載関連

当セグメントは、それまで電子デバイスに含まれていた製品のうち、車載用を切り出したもので、サーモモジュール、パワー半導体基板、センサの 3 つのサブセグメントに分かれる。

(1) サーモモジュール (2025 年 3 月期対総売上高比率 2.3%)

主に自動車の温調シートや冷蔵庫用などに使われる。

(2) パワー半導体基板 (同 7.0%)

主に EV 自動車向けの AMB (Active Metal Brazing) 基板と DCB (Direct Copper Bonding) 基板。

(3) センサ (同 1.7%)

自動車向けのセンサ。

5. その他

その他には、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品、子会社アサヒ製作所のリネン系洗剤、受託作業等が含まれる。

6. 特色、強み

(1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド (SiC) など幅広い無機系素材の生成、加工などに長年携わってきた。そのため、同社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ (素材の性質、生成方法、加工方法等) が蓄積されており、これが同社の特色でもあり強みと言える。

(2) 製造装置も手掛ける

同社は、素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対しては、素材、加工部品、最終製品、製造装置など様々な提案 (ソリューションの提供) を行うことができる。

事業概要

(3) ワンストップソリューションが可能

同社は、半導体製造装置内の部品の洗浄（取り外し、洗浄、据付）や製造装置の組立サービスなどの事業も展開しており、顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで外注化（アウトソーシング）することが可能であり、これも同社の強みと言える。

(4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーが多い。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたり製品や部品を供給しており、これら顧客との深い信頼関係も同社の財産であり強みとなっている。

業績動向

2025 年 3 月期は増収ながら新工場立ち上げにより営業減益

1. 2025 年 3 月期の業績概要

(1) 損益状況

2025 年 3 月期の業績は、売上高が前期比 23.4% 増の 274,390 百万円、営業利益が同 3.1% 減の 24,089 百万円、経常利益が同 3.7% 減の 25,558 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同 3.6% 増の 15,692 百万円となった。

主要顧客からの需要が強含みで推移したことから半導体等装置関連、電子デバイス、車載関連の各セグメントで売上高は伸長した。売上総利益率は 26.7%（前期は 31.4%）と前期比で低下したが、これは太陽光発電向け増設やウエハ受託生産の収益悪化に加えてマレーシアを中心とした生産拠点の新増設コスト負担による。この結果、売上総利益は 73,361 百万円（前期比 5.0% 増）にとどまり、販管費が計画どおり同 9.5% 増となったことから、営業利益は微減益となった。

営業外収益で為替差益が 1,707 百万円（前期は 1,383 百万円）、補助金収入が 5,284 百万円（同 3,482 百万円）と前期比で増加したが、営業外費用で持分法による投資損失が 5,420 百万円（同 3,742 百万円）となったことなどから経常利益の減益幅は 3.7% となった。特別損益では、前期比で大きな増減の変動はなかったが、非支配株主に帰属する当期純利益（マイナス項目）が 3,607 百万円（同 5,481 百万円）に減少したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比 3.6% 増となった。

マレーシアの新工場や常山のセラミックス工場などを中心に設備投資額は 51,776 百万円（前期は 75,227 百万円）、減価償却費は 23,672 百万円（同 16,398 百万円）であった。この結果、EBITDA（償却前営業利益）は 47,761 百万円（前期比 15.7% 増）となった。

業績動向

2025 年 3 月期の業績

(単位：百万円)

	24/3 期		25/3 期		増減額	増減率
	実績	売上比	実績	売上比		
売上高	222,430	100.0%	274,390	100.0%	51,960	23.4%
売上総利益	69,856	31.4%	73,361	26.7%	3,504	5.0%
販管費	44,984	20.2%	49,271	18.0%	4,287	9.5%
営業利益	24,872	11.2%	24,089	8.8%	-782	-3.1%
経常利益	26,537	11.9%	25,558	9.3%	-979	-3.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,154	6.8%	15,692	5.7%	538	3.6%
設備投資額	75,227	-	51,776	-	-23,451	-31.1%
減価償却費	16,398	-	23,672	-	7,273	44.4%

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

高水準の設備投資が続き、資産は大幅増。 一方で有利子負債は 275 億円増加

(2) 財務状況

2025 年 3 月期末の財務状況は、流動資産は 295,367 百万円（前期末比 46,959 百万円増）となった。主に現金及び預金の増加 472 百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加 33,667 百万円、棚卸資産の増加 15,168 百万円による。売上増加に伴い売上債権及び棚卸資産が増加した。固定資産は 305,226 百万円（同 43,608 百万円増）となった。主に設備投資による有形固定資産の増加 43,724 百万円、無形固定資産の減少 445 百万円（主にのれんの減少 149 百万円、その他の減少 296 百万円）、投資その他の資産の増加 330 百万円（主に、投資有価証券の増加 3,234 百万円、関係会社株式の減少 3,522 百万円、繰延税金資産の増加 557 百万円）であった。その結果、資産合計は 600,593 百万円（同 90,566 百万円増）となった。

負債合計は 277,043 百万円（前期末比 45,183 百万円増）となった。主に支払手形及び買掛金の増加 17,290 百万円、短期借入金の増加 8,028 百万円、1 年内返済予定の長期借入金（社債含む）の増加 3,570 百万円、社債の減少 320 百万円、長期借入金の増加 15,858 百万円による。これにより、期末の有利子負債は 162,296 百万円（同 27,136 百万円増）となった。また純資産合計は 323,549 百万円（同 45,383 百万円増）となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加 10,553 百万円、円安による為替換算調整勘定の増加 21,543 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 318 百万円などによる。この結果、期末の自己資本比率は 39.4%（前期末 40.1%）となり、目標である 40% を若干だが下回った。

業績動向

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	24/3 期末	25/3 期末	増減額
現金及び預金	117,254	117,727	472
売掛債権	61,940	92,608	30,667
棚卸資産	56,909	72,078	15,168
流動資産計	248,408	295,367	46,959
有形固定資産	201,339	245,064	43,724
無形固定資産	6,611	6,166	-445
投資その他の資産	53,666	53,996	330
固定資産計	261,618	305,226	43,608
資産合計	510,026	600,593	90,566
支払手形及び買掛金 (電子記録債務を含む)	42,301	59,591	17,290
短期借入金	26,454	34,482	8,028
1 年内返済の長期借入金と 1 年内償還予定の社債	21,022	24,592	3,570
流動負債計	122,148	151,750	29,602
社債	320	-	-320
転換社債型新株予約権付社債	25,000	25,000	-
長期借入金	62,364	78,222	15,858
固定負債計	109,712	125,292	15,580
負債合計	231,860	277,043	45,183
非支配株主持分	73,756	86,718	12,961
純資産合計	278,166	323,549	45,383

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

(3) キャッシュ・フローの状況

2025 年 3 月期の営業活動によるキャッシュ・フローは 26,066 百万円の収入であった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上 25,046 百万円、減価償却費 23,672 百万円、持分法による投資損失 5,420 百万円、仕入債務の増加 11,684 百万円などで、主な支出は持分変動益 349 百万円、売上債権の増加 22,550 百万円、棚卸資産の増加 10,500 百万円などによる。投資活動によるキャッシュ・フローは 39,627 百万円の支出であった。主に定期預金の増加（ネット）による支出 37,327 百万円、有形固定資産の取得による支出 51,239 百万円、投資有価証券の取得による支出 1,136 百万円による。財務活動によるキャッシュ・フローは 18,965 百万円の収入であった。主な収入は長短借入金の増加（ネット）26,851 百万円、非支配株主からの払込みによる収入 2,997 百万円で、主な支出は社債の償還 3,763 百万円、配当金の支払額 4,932 百万円であった。

以上から 2025 年 3 月期の現金及び現金同等物は前期末比 12,092 百万円増加し、期末残高は 108,899 百万円となった。

業績動向

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	24/3 期	25/3 期
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,720	26,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	-92,400	-39,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,419	18,965
現金及び現金同等物の増減額	901	12,092
現金及び現金同等物の期末残高	96,806	108,899

出所：決算短信よりフィスコ作成

主力の半導体等装置関連は増収ながら経費・償却負担で減益、電子デバイスは増益ながら車載関連は減益

2. セグメント別概況

セグメント別状況を見ると、主力の半導体等装置関連は、売上高 165,245 百万円（前期比 27.0% 増）、営業利益 12,305 百万円（同 24.3% 減）となった。米国や中国の顧客からの需要を取込み増収となったが、製品構成の変化（収益性の低い製品の割合が増加）や新工場の立ち上がり負担（減価償却及び経費増）によりセグメント利益は減益となった。

電子デバイスの売上高は 50,487 百万円（前期比 21.0% 増）、営業利益は 8,250 百万円（同 20.8% 増）となった。サーモモジュールが生成 AI 向けで堅調に推移したことなどから増収・増益となった。

車載関連の売上高は 30,463 百万円（前期比 17.7% 増）、営業利益は 3,599 百万円（同 11.4% 減）となった。主力のパワー半導体基板は増収となったが、需要が調整局面となったことなどから減益となった。

その他の売上高は 28,194 百万円（前期比 13.9% 増）、営業利益は 843 百万円（前期は 1,197 百万円の損失）となった。引き上げ装置の売上増があったことや太陽光関連のマイナスが減少していることから、セグメント収益は大きく改善した。

フェローテック | 2025 年 8 月 14 日 (木)
6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

セグメント別売上高・営業利益

(単位：百万円)

	24/3 期		25/3 期			
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	222,430	100.0%	274,390	100.0%	51,960	23.4%
半導体等装置関連	130,072	58.5%	165,245	60.2%	35,172	27.0%
真空シール・金属加工	25,242	11.3%	39,195	14.3%	13,953	55.3%
石英製品	28,242	12.7%	31,930	11.6%	3,688	13.1%
シリコンパーツ	14,604	6.6%	13,687	5.0%	-917	-6.3%
セラミックス	24,314	10.9%	33,155	12.1%	8,841	36.4%
CVD-SiC	6,836	3.1%	8,192	3.0%	1,356	19.8%
EB ガン・LED 蒸着装置	5,935	2.7%	8,242	3.0%	2,307	38.9%
ウエーハ加工	129	0.1%	10	0.0%	-119	-92.2%
再生ウエーハ	1,780	0.8%	2,856	1.0%	1,076	60.5%
装置部品洗浄	11,719	5.3%	15,306	5.6%	3,587	30.6%
石英坩堝	11,268	5.1%	12,668	4.6%	1,400	12.4%
電子デバイス	41,727	18.8%	50,487	18.4%	8,759	21.0%
サーモモジュール	19,348	8.7%	27,225	9.9%	7,877	40.7%
パワー半導体基板	16,772	7.5%	18,152	6.6%	1,380	8.2%
磁性流体・その他	922	0.4%	1,137	0.4%	215	23.3%
センサ	4,682	2.1%	3,971	1.4%	-711	-15.2%
車載関連	25,872	11.6%	30,463	11.1%	4,591	17.7%
サーモモジュール	3,544	1.6%	6,412	2.3%	2,868	80.9%
パワー半導体基板	15,754	7.1%	19,250	7.0%	3,496	22.2%
センサ	6,572	3.0%	4,801	1.7%	-1,771	-27.0%
その他	24,757	11.1%	28,194	10.3%	3,436	13.9%
営業利益	24,872	11.2%	24,089	8.8%	-782	-3.1%
半導体等装置関連	16,260	-	12,305	-	-3,954	-24.3%
電子デバイス	6,829	-	8,250	-	1,420	20.8%
車載関連	4,060	-	3,599	-	-460	-11.4%
その他	-1,197	-	843	-	2,041	-
調整額	-1,080	-	-909	-	170	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

主要なサブセグメントの状況は以下のとおりである。

(1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工、再生ウエーハ

真空シール・金属加工の売上高は、中国半導体装置関連の需要を取り込み 39,195 百万円（前期比 55.3% 増）となった。ただし、開始時コスト負担があり利益寄与は小さい。

ウエーハ加工は、持分法適用子会社の売上減により売上高は 10 百万円（前期比 92.2% 減）となった。再生ウエーハの売上高は 2,856 百万円（同 60.5% 増）となった。

業績動向

(2) 半導体材料、石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC、装置部品洗浄、石英坩堝

石英製品は、顧客在庫の影響があったが、中国の顧客や火加工需要を取込み、売上高は 31,930 百万円（前期比 13.1% 増）となった。シリコンパーツは、顧客の在庫増により売上高は 13,687 百万円（同 6.3% 減）にとどまった。セラミックスは、米国メーカー向け需要が堅調だったことに加えて中国での需要も増加し、売上高は 33,155 百万円（同 36.4% 増）となった。CVD-SiC は、岡山工場のキャパ増強が貢献し売上高は 8,192 百万円（同 19.8% 増）となった。

装置部品洗浄では、中国半導体・液晶工場の稼働が順調に回復したことから売上高は 15,306 百万円（前期比 30.6% 増）となった。一方で石英坩堝は、太陽光発電向けの需要が急減して売上高は 12,668 百万円（同 12.4% 増）にとどまった。そのため、収益性は急激に悪化した。

(3) サーモモジュール

電子デバイスの中のサーモモジュールは、生成 AI サーバー投資関連の光トランシーバー向けマイクロモジュールがけん引して売上高は 27,225 百万円（前期比 40.7% 増）となった。車載関連では、中国 EV 車向けの車載冷蔵庫、カップホルダー向け、温調シート用が堅調に推移して売上高は 6,412 百万円（同 80.9% 増）となった。

(4) パワー半導体基板、センサ

電子デバイスの中のパワー半導体基板は、産業機械向け（主に DCB 基板）が堅調に推移して売上高は 18,152 百万円（前期比 8.2% 増）となった。車載関連のパワー半導体基板（主に AMB 基板）の売上高は 19,250 百万円（同 22.2% 増）となったが、全体が調整局面にあり収益性は低下した。

センサでは、電子デバイスは 3,971 百万円（前期比 15.2% 減）、車載関連は 4,801 百万円（同 27.0% 減）といずれも前期比でマイナスとなったが、これは主に大泉製作所の決算期変更（9 ヶ月決算）による。実態としては、まずまずの結果だったようだ。

3. 主な投資と減価償却費

2025 年 3 月期の設備投資額は 51,776 百万円（前期は 75,227 百万円）となった。主な投資は、マレーシア FTMM85 億円、マレーシアパワー半導体基板 92 億円、常山セラミックス等 35 億円、麗水センサ 50 億円、日本国内の FTMT・FTHD61 億円等であった。

減価償却費は 23,672 百万円（前期は 16,398 百万円）と大幅に増加した。

■ 今後の見通し

2026 年 3 月期の営業利益は前期比 16.2% 増予想。 各セグメントで小幅回復予想

1. 2026 年 3 月期の業績見通し

2026 年 3 月期の業績は、売上高 285,000 百万円（前期比 3.9% 増）、営業利益 28,000 百万円（同 16.2% 増）、経常利益 26,000 百万円（同 1.7% 増）、親会社株主に帰属する当期純利益 16,000 百万円（同 2.0% 増）を見込んでいる。

世界的に半導体市場が踊り場を迎えている状況で、先行きも不透明であることから主力の半導体等装置関連は前期比 7.4% 増を見込んでいる。電子デバイスでは、パワー半導体基板が調整局面を迎えるものの、サーモモジュールは続伸、センサは回復すると見ており、同セグメントの売上高は同 12.7% 増の予想。車載関連は、サーモモジュールは調整が予想されるがパワー半導体基板は続伸予想、センサも決算期変更の影響もありプラス成長を見ていることから、売上高は同 17.8% 増と予想されている。その他は前期の反動（引き上げ装置の販売）や太陽光関連を縮小することから同 47.5% 減を見込んでいる。

売上高は微増予想だが、利益率の高い製品の割合が増加すること、赤字製品が大幅に減少することなどから、営業利益は前期比 16.2% 増を見込んでいる。為替差益やその他の特殊要因を見込んでいないことから、経常利益は微増益の予想としている。

フェローテック | 2025 年 8 月 14 日 (木)
6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

2026 年 3 月期の業績見通し

(単位：百万円)

	25/3 期		26/3 期			
	実績	売上比	予想	売上比	増減額	増減率
売上高	274,390	100.0%	285,000	100.0%	10,610	3.9%
半導体等装置関連	165,245	60.2%	177,402	62.2%	12,157	7.4%
真空シール・金属加工	39,195	14.3%	49,774	17.5%	10,579	27.0%
石英製品	31,930	11.6%	31,930	11.2%	0	0.0%
シリコンパーツ	13,687	5.0%	12,968	4.6%	-719	-5.3%
セラミックス	33,155	12.1%	39,142	13.7%	5,987	18.1%
CVD-SiC	8,192	3.0%	8,162	2.9%	-30	-0.4%
EB ガン・LED 蒸着装置	8,242	3.0%	6,127	2.1%	-2,115	-25.7%
ウエーハ加工	10	0.0%	0	0.0%	-10	-
再生ウエーハ	2,856	1.0%	4,427	1.6%	1,571	55.0%
装置部品洗浄	15,306	5.6%	17,597	6.2%	2,291	15.0%
石英坩堝	12,668	4.6%	7,275	2.6%	-5,393	-42.6%
電子デバイス	50,487	18.4%	56,921	20.0%	6,434	12.7%
サーモモジュール	27,225	9.9%	31,181	10.9%	3,956	14.5%
パワー半導体基板	18,152	6.6%	16,719	5.9%	-1,433	-7.9%
磁性流体・その他	1,137	0.4%	1,370	0.5%	233	20.4%
センサ	3,971	1.4%	7,652	2.7%	3,681	92.7%
車載関連	30,463	11.1%	35,878	12.6%	5,415	17.8%
サーモモジュール	6,412	2.3%	5,113	1.8%	-1,299	-20.3%
パワー半導体基板	19,250	7.0%	22,953	8.1%	3,703	19.2%
センサ	4,801	1.7%	7,813	2.7%	3,012	62.7%
その他	28,194	10.3%	14,799	5.2%	-13,395	-47.5%
営業利益	24,089	8.8%	28,000	9.8%	3,911	16.2%
経常利益	25,558	9.3%	26,000	9.1%	442	1.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,692	5.7%	16,000	5.6%	308	2.0%
設備投資額	51,776	-	65,000	-	13,224	25.5%
減価償却費	23,672	-	27,000	-	3,328	14.1%

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

2. サブセグメント別見通し

主要なサブセグメント別売上高の予想は以下のとおりである。

(1) 真空シール・金属加工、ウエーハ加工、再生ウエーハ

半導体製造装置向け金属加工の需要は米国向けが回復基調にあり、中国向けも引き続き堅調の見込みであることから、真空シール・金属加工の売上高は 49,774 百万円（前期比 27.0% 増）と予想している。

ウエーハ加工は縮小方向なので売上高はゼロ予想。一方で、再生ウエーハは本格的に立ち上がることから売上高は 4,427 百万円（前期比 55.0% 増）と予想している。

(2) 半導体材料、装置部品洗浄、石英坩堝

市況悪化を受けた顧客の在庫調整が続いていることから、石英製品の売上高は前期並みの 31,930 百万円（前期比 0.0% 増）を予想。シリコンパーツも顧客の在庫調整により売上高 12,968 百万円（前期比 5.3% 減）を見込む。セラミックスは、米国向けが回復基調にあり、中国向けも増加が見込まれることから売上高は 39,142 百万円（同 18.1% 増）を見込む。CVD-SiC の売上高は、横ばい予想の 8,162 百万円（同 0.4% 減）を見込むが顧客からの引き合いは強く生産能力の増強を継続する。装置部品洗浄は、中国における半導体生産が堅調であることから、売上高は 17,597 百万円（同 15.0% 増）を見込む。石英坩堝は、採算が悪化した太陽光発電向けを抑制し、半導体向け中心にシフトすることから、売上高は 7,275 百万円（同 42.0% 減）の予想としている。

(3) サーモモジュール

電子デバイスのサーモモジュールは、AI 関連の需要が継続することから、売上高は 31,181 百万円（前期比 14.5% 増）を見込む。車載関連は、自動車温調シート向け等が減少見通しであることから、売上高は 5,113 百万円（同 20.3% 減）の予想としている。

(4) パワー半導体基板、センサ

電子デバイスのパワー半導体基板は、中期的な成長は続く見込みだが、足元では需要が弱く売上高は 16,719 百万円（前期比 7.9% 減）を見込む。一方で車載関連のパワー半導体基板（主に DCB 基板及び AMB 基板）は、中国での新エネルギー車（PHEV 車等）向けが堅調に推移する見込みであることから売上高は 22,953 百万円（同 19.2% 増）を見込む。

センサは、電子デバイス、車載関連ともに需要が回復する見込みであることに加えて決算期変更の影響（前期は 9 ヶ月分のみ）により、電子デバイスが 7,652 百万円（前期比 92.7% 増）、車載関連が 7,813 百万円（同 62.7% 増）を予想している。

3. 投資額と減価償却費の見通し

設備投資額は 65,000 百万円と増加予想で、マレーシア FTMM 投資、マレーシアパワー半導体基板、常山セラミックス・CVD-SiC 等への投資を計画している。減価償却費は 27,000 百万円（前期比 14.1% 増）を見込んでおり、これにより EBITDA は 55,000 百万円（同 15.2% 増）の見込みである。

■ 中長期の成長戦略

2028 年 3 月期に営業利益 470 億円、ROE15% を目指す

1. 中期経営計画の基本方針

同社では、2024 年春に 2027 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を発表していたが、足元の半導体業界の動向等を踏まえてこの計画を見直し、新たに 2028 年 3 月期を最終年度とする計画を発表した。ただし、定性的な目標（戦略）は変わっておらず、以下の 4 つの基本方針を推進する。

(1) 事業成長

- ・半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する。
- ・米中摩擦による中国外製造（Ex-China）のニーズに対応してマレーシア等の中国外製造を強化しながら、中国における半導体関連ニーズの取込みを進める。

(2) 収益性向上・生産効率向上

- ・マレーシア（クリム、ジョホール）工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引上げを実現する。
- ・デジタル化・自動化・AI 化を展開し、生産効率向上・競争力強化を追求する。
- ・新製品・新技術の開発を推進・強化し、「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続する。

(3) 人材強化・企業文化

- ・人材重視を重要な経営戦略とし、人材の採用及び育成を推進する。
- ・企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する。

(4) 財務・株主還元

- ・中国上場の洗浄事業子会社 FTSVA とパワー半導体基板子会社 FLH の統合実現後には株式時価が増加見通しであり、活用方法を検討する。
- ・新たな株主還元方針に則り、DOE（株主資本配当率）を採用し、自社株式の取得も機動的に検討する方針である。

2. 定量的目標（KPI）

(1) 利益計画

2028 年 3 月期までの 3 年間の売上高、営業利益、利益率等の目標は以下のようになっており、最終年度である 2028 年 3 月期には売上高 4,000 億円、営業利益 470 億円、ROE15%、自己資本比率 40% の維持を目指す。

フェローテック | 2025 年 8 月 14 日 (木)
6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中長期の成長戦略

中期経営計画 KPI

(単位：百万円)

	25/3 期 実績	26/3 期 予想	27/3 期 計画	28/3 期 計画
売上高	274,390	285,000	340,000	400,000
営業利益	24,089	28,000	35,000	47,000
(営業利益率)	8.8%	9.8%	10.3%	11.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000
ROE	7.1%			15%
ROIC※1	3.9%			8%
自己資本比率	39.4%	40%		
設備投資額	51,776	65,000	45,000	30,000
1 株当たり年間配当金 (円)	141.0	148.0	DOE (連結株主資本配当率※2) を採用し、下限を 3.5% に設定 自己株式取得を機動的に検討、総還元性向 50% を目指す	

※ 1：ROIC = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ (有利子負債 + 純資産)、純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

※ 2：連結株主資本 = 資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式、連結株主資本配当率 = 配当金総額 ÷ 連結株主資本

出所：決算説明資料よりフィスコ作成

(2) 投資計画及びキャッシュ・フロー見通し

今後 3 ケ年の設備投資は累計 1,400 億円を計画している。

主な投資内容は、半導体関連顧客からの 2025 年以降のキャパ増強の要請へ対応するための能力増強投資である。また米中間の貿易摩擦等を考慮して、中国外の生産体制を強化する。パワー半導体基板等の自動車セグメントへの投資も継続する。

この間の営業キャッシュ・フローの増加により、フリーキャッシュ・フローは改善する見通しである。

3. 主要製品別戦略と売上高目標

(1) 石英

(中長期業績見通し)

・欧米顧客は、ユーザー在庫の影響を 2025 年も一部残存を織り込み、回復本格化は 2025 年後半以降だが中期的な需要は拡大する見通し。クリム工場黒字化、生産拡充・効率性向上を進め、収益性向上を図る。

(設備投資・生産能力の状況)

・欧米顧客は中期的な需要が増加する見通し。増産要請に対応し、クリム第二工場を着工。拡大する中国顧客の需要を、中国内キャパにて対応する。

石英中長期業績見通し (売上高目標：百万円)



中長期の成長戦略

(2) セラミックス

(中長期業績見通し)

- ・欧米顧客の需要は2025年後半に増加見通し、中期的な需要は拡大見通し。中国市場も中期的には拡大見通し。

(設備投資・生産能力の状況)

- ・欧米顧客の中期的な需要増加見通し、増産要請に対応し、クリム第二工場を着工。拡大する中国顧客の需要を、中国内キャパにて対応する。

セラミックス中長期業績見通し（売上高目標：百万円）



(3) CVD-SiC

(中長期業績見通し)

- ・CVD-SiC は需要拡大が継続する見通し。岡山工場のキャパ拡充、常山工場の立ち上げにより、売上の拡大を図る。

(設備投資・生産能力の状況)

- ・常山工場の生産ライン立ち上げ中、生産キャパを引上げ、さらなる需要取込みを図る。

CVD-SiC 中長期業績見通し（売上高目標：百万円）



(4) シリコンパーツ

(中長期業績見通し)

- ・ユーザー在庫の影響継続を織り込み、回復本格化は2026年以降の見通し。ただし、中長期の需要は底堅い見通し。

(設備投資・生産能力の状況)

- ・欧米顧客の中国外製造ニーズに応え、2025年にマレーシア・ジョホール工場を立ち上げ中、下期生産開始予定（建屋賃借）。

シリコンパーツ中長期業績見通し（売上高目標：百万円）



(5) サーモモジュール

(中長期業績見通し)

- ・AI 関連需要の取込みにより成長継続を見込む。冷却チラー事業の拡充を目指す。

(設備投資・生産能力の状況)

- ・生産の自動化・効率化はさらに進める。中国外製造は検討中。

サーモモジュール中長期業績見通し（売上高目標：百万円）



中長期の成長戦略

(6) パワー半導体基板

(中長期業績見通し)

・パワー半導体基板の中長期的な需要は拡大基調が継続する見通し。DPC 等の製品レンジの拡充、材料内製化、自動化等により事業基盤の拡充を進める。

(設備投資・生産能力の状況)

・四川工場は生産拡充による収益貢献を見込む。マレーシア・ジョホール工場は 2025 年 4 月に生産開始。顧客需要は堅調であり、段階的に稼働が増加する見通し。

パワー半導体基板中長期業績見通し (売上高目標：百万円)



4. 主な工場新設・生産能力増強の状況

成長へ向けて、工場の新設・増設を着々と進め、生産能力を拡大中である。

主な工場新設・生産能力増強の状況

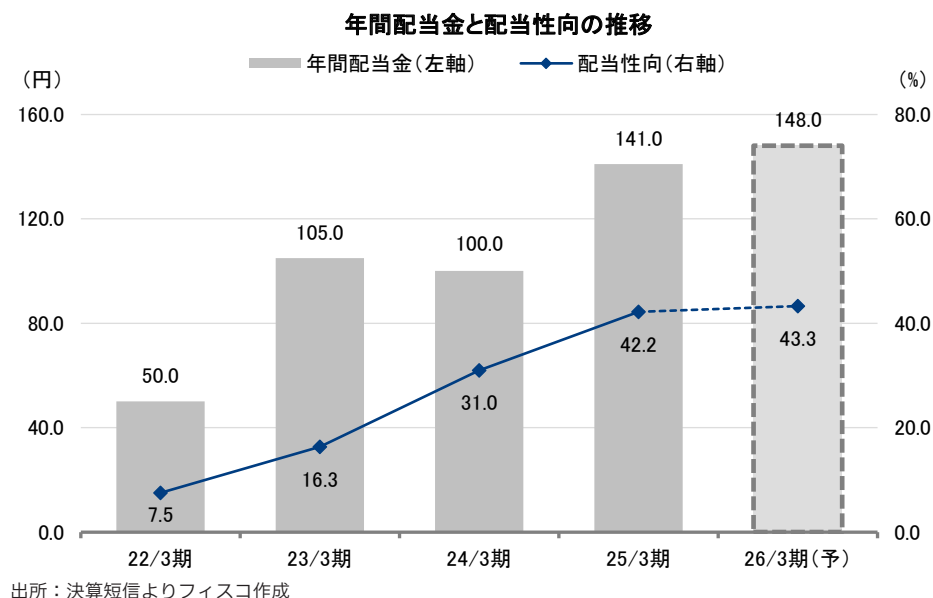
対象事業	所在地	2025	2026	2027	2028	2029	現在の生産能力 (億円)	最大生産能力想定 (億円)
パワー半導体 基板	中国 東台・内江	本格生産 → フル稼働					570	600
パワー半導体 基板	マレーシア	稼働開始	本格生産	フル稼働			70	130
セラミックス	日本 石川県	稼働開始	本格生産	フル稼働			100	140
セラミックス シリコンパーツ	中国 常山	稼働開始	本格生産	フル稼働			100	170
金属加工・石英 セラミックス	マレーシア	稼働開始	本格生産	フル稼働			150	430
洗浄	日本 熊本県	稼働開始	少量生産	フル稼働			0	20

出所：決算説明資料より掲載

株主還元策

2026 年 3 月期は年間 148.0 円配当の予定

同社は株主還元策として配当を実施している。株主還元の強化を図るため、新たに DOE を採用し下限を 3.5% に設定した。持続的な収益増強により配当水準の引上げを目指すとともに、財務の状況等を考慮しながら、自己株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は 50% を目指して充実を図る方針だ。この方針に沿って 2025 年 3 月期は年間 141.0 円（配当性向 42.2%）を行ったが、進行中の 2026 年 3 月期も年間 148.0 円（予想配当性向 43.3%）の配当を発表済みだ。高水準の設備投資を続けながらも、少しずつだが増配を行っている点は評価できる。今後の配当政策にも注目したい。



重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したものです。フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受け、企業から報酬を受け取って作成されています。本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp